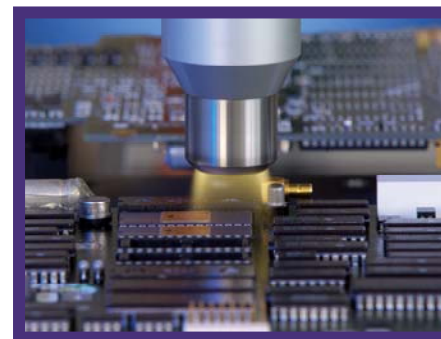
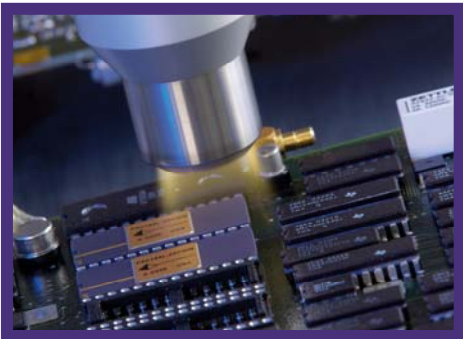


# OPENAIR® PLASMA FÖR PERFEKT KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET!

*Inom elektronikindustrin är förbehandling med Openair® Plasma en viktig tillgång för att uppnå kostnadseffektivitet och processsäkerhet. Openair® Plasma passar även för transparent reptålig beläggning av displayer. Förbehandling med Openair Plasma minskar avsevärt antalet enheter som behöver kasseras och säkerställer en felfri produkt. För lackering eller limning av bestyckade kretskort ser plasmaaktive-*

*ring, mikrorengöring och elektrostatisk urladdning till att beläggningen fäster ordentligt. Openair® mikrorengöring eliminerar behovet av en vakuumkammare för ytaktivering av bestyckade kretskort.*

*Plasmaförbehandling visar vägen, både ekonomiskt och ekologiskt.*



## POTENTIALFRI OPENAIR® PLASMA IDEALISK VID TILLVERKNING AV HÖGKÄNSLIG ELEKTRONIK!

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning har länge varit en del av elektronikindustrin. Före införandet av Openair® plasmatekniken var det endast möjligt i en lågtryckskammare. Lågtrycksplasma leder till långsamma, dyra störningar i produktionsflödet. Dessa begränsningar gör att traditionella plasmalösningar är olönsamma för rengöring och ytaktivering av bestyckade kretskort.

Plasmateat Openair® Plasma-system övervinner dessa hinder och passar även i tillverkningsmetoden. Metoden har fördelen att kunna arbeta i öppen atmosfär, med användning av luft som en processgas, och kan placeras in-line med befintliga processer. Openair Plasma-systemet är spänningsfritt och kommer därför inte att skada ESD-känsliga enheter.

### Openair® plasmprocessen:

- Eliminerar alla organiska och silikonbaserade föroreningar
- Aktiverar ytan genom att införa syre i form av hydroxylgrupper i icke-polära ytor. Resultatet är hög ytenergi och i de flesta fall, fullständig vätbarhet (över 72 dyn).
- Perfekt för wirebonding, lödning, skyddsbeläggning och vid inkapsling
- Avlägsnar effektivt elektrostatiskt attraherat damm
- Ersätter VOC-baserade reningsprocesser